**Ausschreibungstext Massivdiele Breiten- zu Dickenverhältnis max. 10:1 auf Calciumsulfat-/Calciumsulfatfließestrich beheizt – STAUF SPU 510**

**Vorbemerkung/Haftungsausschluss:** Der Erfolg einer Parkett-, Holzpflaster- und Bodenbelagsverlegung ist zum größten Teil von der entsprechenden Untergrundvorbereitung abhängig. Gemäß VOB DIN 18356 „Parkett- und Holzpflasterarbeiten“ VOB DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“ sind im Voraus insbesondere die Trockenheit, Ebenheit und Festigkeit durch den Verleger zu prüfen. Die Ausführung der Arbeiten muss nach den allgemein anerkannten Regeln des Fachs erfolgen. Darüber hinaus sind die aktuellen technischen Merkblätter bzw. die Anweisungen auf den Etiketten unserer Produkte zu beachten. Im Zweifelsfall ist die Rücksprache mit der STAUF Anwendungstechnik (Telefon: +492739-301160 – Mail technik@stauf.de) zu empfehlen.

Da durch uns nicht alle jeweiligen Besonderheiten des Einzelfalls vor Ort vollständig erfasst werden können, sind abweichende Vorgehensweise und Arbeitsfolgen möglich. Die aufgeführten Texte sind lediglich Anhaltspunkte für Ausschreibungen, Planung und Kalkulation. Wir leisten nicht Gewähr, dass die beschriebenen Texte und Arbeitsfolgen bei jedem individuellen Bauvorhaben zur Anwendung kommen können bzw. dürfen.

Leistungsverzeichnis:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Positionsbeschreibung/Leistung | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| 1.0 | …… m² | Calciumsulfat-/Calciumsulfatfließestrich (CA/CAF), beheizt, max. 0,3 CM% Restfeuchte, neu eingebaut nach DIN EN 13813, eben nach DIN 18202 prüfen und vorbereiten, | ………. € | ………. € |
|  | gemäß VOB DIN 18356 „Parkett- und Holzpflasterarbeiten“ prüfen, |
|  | Reinigungsschliff durchführen, absaugen, umVerschmutzungen zu entfernen, bis einbelegereifer Untergrund vorliegt. Abfall istordnungsgemäß zu entsorgen. |
| 2.0 | …… lfm | Risse, Schein- und Arbeitsfugen öffnen, Querschlitze setzen, aussaugen und Wellenverbinder einlegen,  | ………. € | ………. € |
|  |  | kraftschlüssig schließen mit schnell härtendem 2K-Silikatgießharz STAUF SGH 50 oder gleichwertig, |  |  |
|  |  | unmittelbar danach Abstreuen der noch frischen Schicht im Überschuss mit STAUF Quarzsand (Körnung 0,4 - 0,8 mm) oder gleichwertig. |  |  |
|  |  | Produkteigenschaften 2K-Silikatgießharz:* geruchsarm
* einfache Verarbeitung
* schnell überarbeitbar
* Lösemittelfrei
* GEV-Emicode EC1+ - sehr emissionsarm

Verbrauch ist abhängig von Breite und Tiefe der Risse/Fugen. Bei einer Rissbreite von 5mm und Risstiefe von 5cm (Estrich ist bis zur Hälfte eingeschnitten) ca. 3 bis 4 lfm pro EinheitAngebotenes Gießharz: ………. |  |  |
| 3.0Alternativpos. | …… m² | Grundieren von neuen, calciumsulfatbasierten, trockenen Untergründen mit lösemittelfreien Dispersionsgrundierung STAUF VDP 130 oder gleichwertig, | ………. € | ………. € |
|  |  | Auftrag mit Rolle  |  |  |
|  |  | Grundierung vor der Klebung mit STAUF-Parkettklebstoffen  |  |  |
|  |  | Bei der Verwendung unter Klebstoffen 1:1 mit Wasser verdünnen |  |  |
|  |  | Produkteigenschaften Grundierung:* leicht aufzutragen
* schafft eine gleichmäßige saugfähige Oberfläche
* universell einsetzbar
* GISCODE D1 - Lösemittelfrei
* GEV-Emicode EC1+ - sehr emissionsarm
* Verbrauch ca. 120 g/m² bzw. 60 g/m² bei Auftrag mit Rolle

Angebotene Grundierung: ………. |  |  |
| 4.0 | …… m² | Massivdielen, Breiten- zu Dickenverhältnis max. 10:1, liefern und vollflächig verkleben mit hartem 1-Komponenten SPU-Parkettklebstoff nach ISO 17178Hersteller:Bezeichnung:Holzart:Sortierung:Breite:Dicke (max. 22 mm):Länge: | ………. € | ………. € |
|  |  | vollflächig verkleben mit hartem 1-Komponenten SPU-Parkettklebstoff nach ISO 17178 STAUF SPU 510 oder gleichwertig |  |  |
|  |  | Produkteigenschaften Parkettklebstoff:* sehr geringe Dichte
* sehr geringer Verbrauch
* harter Klebstoff nach ISO 17178
* keine migrationsfähigen Bestandteile
* GISCODE RS10 - Lösemittelfrei
* GEV-Emicode EC1+ - sehr emissionsarm
* DIBt-Zulassung

Verbrauch mit Zahnspachtel Nr. 4 (TKB B15) oder STAUF Nr. 14 ca. 750 g/m² bzw. 1300 g/m²Angebotener Parkettklebstoff: ………. |  |  |